

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年6月5日(05.06.2025)



(10) 国際公開番号

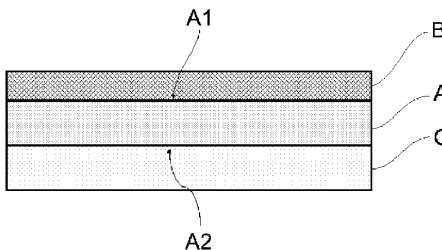
WO 2025/115422 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 23/28 (2006.01) C09J 175/04 (2006.01)
C09J 7/30 (2018.01) C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/00 (2006.01) C09J 201/00 (2006.01)
C09J 123/00 (2006.01) H01L 21/56 (2006.01)
C09J 125/04 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
C09J 133/00 (2006.01) H01L 23/12 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/036424
- (22) 国際出願日: 2024年10月11日(11.10.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-201053 2023年11月28日(28.11.2023) JP
- (71) 出願人: 三井化学 ICT マテリア株式会社(MITSUI CHEMICALS ICT MATERIA, INC.)
[JP/JP]; 〒1040028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 (JP).
- (72) 発明者: 三浦 徹(MIURA Toru); 〒4570801 愛知県名古屋市中区丹後通2-1 三井化学 ICT マテリア株式会社内 (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治, 外 (HAYAMI Shinji et al.); 〒1410031 東京都品川区西五反田7丁目9番2号 KDX五反田ビル9階 (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: ADHESIVE FILM AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 粘着性フィルムおよび電子装置の製造方法

100



(57) Abstract: This adhesive film (100) comprises: a substrate layer (A); an adhesive resin layer (B) for temporarily fixing an electronic component on a first surface (A1) side of the substrate layer (A); and an adhesive resin layer (C) provided on a second surface (A2) side of the substrate layer (A), wherein a test piece having a size of 5 cm×5 cm is prepared from the adhesive film (100), a pressurizing and heating treatment is performed for 1 minute under the conditions of a temperature of 190°C, a load of 100 kN, and a humidity of 65% Rh in a state in which the test piece is sandwiched between two SUS plates having a size of 15 cm×15 cm, and the arithmetic average height Sa of the surface on the reverse side of the adhesive resin layer (C) from the substrate layer (A), as measured after the pressurizing and heating treatment, is at least 5.5 μm.

[続葉有]

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 基材層 (A) と、前記基材層 (A) の第 1 面 (A 1) 側に、電子部品を仮固定するための粘着性樹脂層 (B) と、前記基材層 (A) の第 2 面 (A 2) 側に粘着性樹脂層 (C) と、を含む粘着性フィルム (100) であって、粘着性フィルム (100) から 5 cm × 5 cm の試験片を作製し、前記試験片を 15 cm × 15 cm の SUS 板 2 枚の間に挟んだ状態で、温度 190℃、荷重 100 kN、湿度 65% Rh の条件下で 1 分間加圧加熱処理した後における、前記粘着性樹脂層 (C) の前記基材層 (A) とは反対側の面の算術平均高さ Sa が 5.5 μm 以上である、粘着性フィルム (100)。